

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

合肥晶合集成电路股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、泰康资产、中信证券、拾贝投资、高腾资产、久期投资、鹏扬基金、中英人寿、安捷国际、天弘基金
会议时间	2026 年 8 月 25 日-2026 年 8 月 26 日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黄凯全 发展规划处副处长 曹宗野 证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	介绍公司 2026 年上半年业绩情况： 2026 年上半年公司实现营业收入约 59.57 亿元，较去年同期增长 14.59%；实现经营性现金流量净额 27.98 亿元，较上年同期增长 64.10%；综合毛利率为 21.69%。 从制程节点分类看，55nm 及以下、90nm、110nm、150nm 占主营业务收入的的比例分别为 14.29%、39.38%、26.72%、19.61%，55nm 及以下制程营收占比持续提升；从应用产品分类看，DDIC、CIS、PMIC、Logic、MCU 占主营业务收入的的比例分别为 53.24%、25.34%、12.82%、4.02%、4.25%，其中 CIS 和 PMIC 产品营收占比不断提升，产品结构不断优化。 问题 1：请问公司现在总产能达到多少？产能利用率情况如何？ 答复：截至 6 月底，公司总产能约 16 万片/月，产能利用率维持在高位。 问题 2：终端消费电子市场景气度一般，为什么公司还可

	以保持高稼动率？ 答复：AI 产业发展为国内集成电路制造行业带来新的机遇：一方面 AI 技术的发展催生了新的应用领域，市场规模扩张，另一方面，海外供给端产能被 AI 产品挤压，其他品类制造订单外溢。同时公司也在积极拓展新产品方向，提升公司的竞争力，为客户提供稳定且高效的代工服务。 问题 3：公司目前的研发进展如何？ 答复：28nm OLED 及 110nm 高像素密度高阶硅基 OLED 显示驱动芯片产品验证中；55nm 高效能高动态范围成像技术图像传感器工艺平台开发完成，90nm 高阶近红外感光图像传感器已实现小批量生产；28nm 逻辑工艺平台已导入客户样品流片验证中，22nm 逻辑芯片工艺开发中。 问题 4：请问公司四期项目扩产的制程和终端应用产品？目前扩产进度如何？ 答复：公司四期项目将建设一条产能为 5.5 万片/月的 12 英寸晶圆代工生产线，布局 40nm 及 28nm 的 CIS、OLED、逻辑等工艺，产品可广泛应用于 OLED 显示面板、AI 手机、AI 电脑、智能汽车、人工智能及存储等领域。目前四期项目正在进行无尘室的装修，扩产工作稳步推进中。 问题 5：请问公司扩产需要的设备是否可以正常采购？ 答复：公司设备的采购和交付正常，同时公司也在满足使用需求的前提下积极采用国产化设备，保障公司的供应链稳定。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 8 月 27 日